# 전기폭발법을 이용한 자성 나노분말 제조

박중학<sup>1,2\*</sup>, 이동진<sup>1,2</sup>, 홍순직<sup>2</sup> 「(주)나노기술 <sup>2</sup>공주대학교 신소재공학부

# 1. 서론

최근 전자파의 폐해가 알려지면서 각국의 전자파 허용 규제치가 엄격해지고 있는 가운데 스마트폰, 태블릿, 노트북 등의 개인 전자통신기기가 급속도록 보급되어 시장이 급팽창하였을 뿐만 의료기기, 차량, 군수산업에서 도 전자기기의 도입으로 전자파 차폐에 대한 요구가 증가하고 있다. 특히 전자기기의 정보처리속도 고속화(고 주파 화)와 IC기술에 의한 고집적화(소형화 및 모바일 화)가 이루어지는 가운데 전자파 흡수에 의한 차폐소재의 박형화에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[1,2]. 한편 전자파차폐소재로 벌크금속을 사용할 경우 높은 가공비용과 성형성의 제약으로 인해서 용도가 한정될 수 있으나 나노화하여 복합체형태로 사용할 경우 박형화뿐만 아니라 경량화도 가능하다. 이에 본 연구에서는 전기폭발법을 이용하여 나노크기의 다양한 자성분말을 제조하여 기본적인 물성을 평가하고 일부는 전자파흡수 특성을 조사하였다.

# 2. 실험방법과 결과

전기폭발법(Pulsed Wire Evaporation method)을 이용하여 투자율이 높은 permalloy(Fe-Ni), 연자성 Ni 나노분말을 제조하였다. 나노분말의 표면은 산화막처리(passivation) 및 카본코팅을 실시하여 각각의 특성을 조사하였다. 제조된 분말의 입도는 인가에너지에 따라 구형의 평균 50nm~500nm를 나타냈고 표면이 카본으로 코팅된 분말의 경우 열적안정성이 더 우수한 것을 확인하였다. 제조된 나노분말은 일정량의 CNT와 함께 폴리머에 혼합, 분산시킨 후 sheet, film 형태로 성형하여 투자율 측정 및 전자파 흡수 특성을 조사하였다.

#### 3. 고착

나노 금속분말을 이용하여 전자파차폐효과를 증가시키기 위해서는 나노 분말의 종류, 표면상태, 입도 등이 중요한 요소로 보이며, 복합체 성형시 매트릭스 내에 나노입자 및 카본의 분산상태가 매우 중요하며 특히 입자 상호간 네트워크가 잘 형성될 수 있도록 설계 및 가공하는 연구가 향후 지속되어야 될 것으로 판단된다.

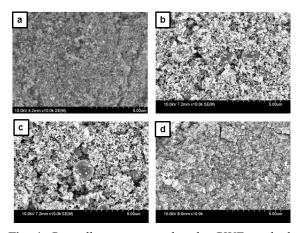


Fig. 1. Permalloy nano powders by PWE method.

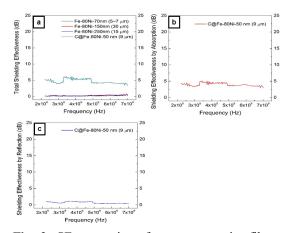


Fig. 2. SE properties of nano composite films.

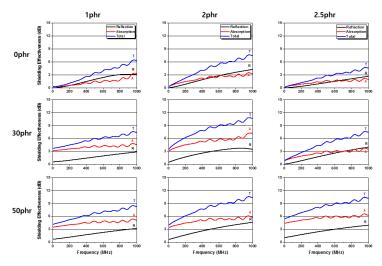


Fig. 3. SE properties of nano metal powder/carbon composites.

## 4. 결론

연자성 Ni 나노분말 및 퍼멀로이 나노분말을 전기폭발법을 이용하여 제조하였다. 분말의 표면은 산화막 및 카본막으로 개질하였고 제조된 분말은 구형이며 조건에 따라 평균 50nm~500nm의 입도를 나타내었다. 필름 형태로 제조된 경우 2.2~7.1GHz영역에서 산화막 코팅된 경우 전자파 차폐특성이 미미하였으며 카본 코팅된 경우는 약 5dB 수준의 차폐효과를 보이는 데 주로 흡수에 의한 효과로 사료된다. 입자크기에 따른 차폐율 효과에서는 50nm 입자가 300nm 크기의 입자보다 효과가 큰 것으로 확인되었으며 50nm 입자의 경우는 반사보다흡수에 기인한 차폐로 사료된다. CNT가 추가로 첨가되었을 경우 전체적인 차폐율은 증가하였는데 이는 전도도향상에 기인한 것으로 보이며 분말량이 증가함에 따라 차폐효율은 증가하는 경향을 나타내었다.

## 5. 참고문헌

- [1] M. Hirou, Electromagnetic Shielding and Absorbing Practical Technology Practical Manual, Mimatsu Co. Tokyo, 2006.
- [2] H. S. Cho et al., Microwave Absorbing Properties of Rubber Composites Containing Soft Magnetic Fe-Alloy Particles, J. Kor. Powd. Met. Inst., Vol. 20, No. 2, 2013